

电子主板结构胶：Hongjin-D6099

产品名称	电子主板结构胶：Hongjin-D6099
公司名称	深圳市宏进科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路49号5B栋501
联系电话	0755-28307837 18688927121

产品详情

型号：Hongjin-D6099

规格：50ml/支

特点：导电性能优异，导热系数高，固化速度快，操作方便，可根据客户需求调整产品粘度、硬度、固化速度等。

适用产品：

- 1、用于各种材料结构粘接，包括金属、陶瓷、玻璃、木材和各种塑料
- 2、用于各种元件密封、填充、防水、补强等
- 3、用于各种器件和设备的填充、导热、导电等

优势：

- 1.快速自然固化，操作窗口宽
- 2.低膨胀系数，耐高低温、抗冲击效果好
- 3.特殊的导热、导电性能化

技术参数：

外观	A组分 透明 B组分 透明
混合比	1:1
凝胶时间	3min
定位时间	5~8min
混合粘度	8000~10000

固化后性能

颜色	透明
密度 (g/cm ³)	1.2
硬度	D75
线膨胀系数 (PPM/)	60
玻璃化转变温度 ()	80
剪切强度 (MPa)	15
介电强度 (KV/mm)	18
体积电阻率 (.cm)	4x10 ¹⁵

注意事项：

- 使用。产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的包封材料
- 2、 放置在小孩触摸不到的地方。
 - 3、 为避免污染原装包封剂，不得将任何用过的包封剂倒回原包装内。

储存：

本品应存放在25 的环境中，以避免其性能发生变化。